

LDS工法 MID対応 無電解めっきプロセス

Electroless Plating Process for MID with LDS

- レーザー加工部へのめっき析出性およびパターン性に優れる。
- 電気めっきをするための導電層を一段めっきで形成可能。
- 耐熱性の低い樹脂素材にも適応可能な低温めっきプロセス
- Excellent deposition ability and fine circuit pattern ability to laser processing part
- Can form conductive layer, by one-step plating, which is electro-plated
- Low temperature plating process which can be applicable to resin material to have a low heat-resistance

処理工程 Process

